



# 半导体行业专用压力表 GW35 · 45

## 概述

该产品可测量高纯度的半导体气体，可用于存在腐蚀性的空气等恶劣的场合，由于制作时充分考虑到该产品的气密性和清洁度，因此非常适合应用于半导体生产线和测量高纯净流体。

## 特征

- 波登管、底座、外壳以及内部机芯都是由不锈钢制成，具有极好的耐腐蚀性。
- 接液部利用氩弧焊接法焊接，耐压以及气密性极好。


※请将压力的范围置于满刻度的30%~65%之间，这时压力表的测量最准确。也请确定压力表接液部的材质是否适合被测流体。

## 规格

### 测量介质:

气体或液体

### 形状:

面板安装  D型 (中心底座、轴向)

### 表盘尺寸:

φ 35 (型号: GW35)

φ 40 (型号: GW45)

### 连接口径:

9/16-18UNF (M)、9/16-18UNF (F)

### 接液部材质:

波登管、接头 EP级: SUS316L

BA级: SUS316L

外壳 SUS304 (原色)

内部机芯 SUS制

### 焊接方式:

氩弧焊接

### 压力范围:

0~0.4→0~3.5MPa

-0.1~0.3→-0.1~2MPa

### 精度:

±3%F.S.

### 气密性 (He 真空法):

EP级:  $1.01 \times 10^{-9} \text{ Pa} \cdot \text{m}^3/\text{s}$ 以下

BA级:  $1.01 \times 10^{-9} \text{ Pa} \cdot \text{m}^3/\text{s}$ 以下

### 清洁度:

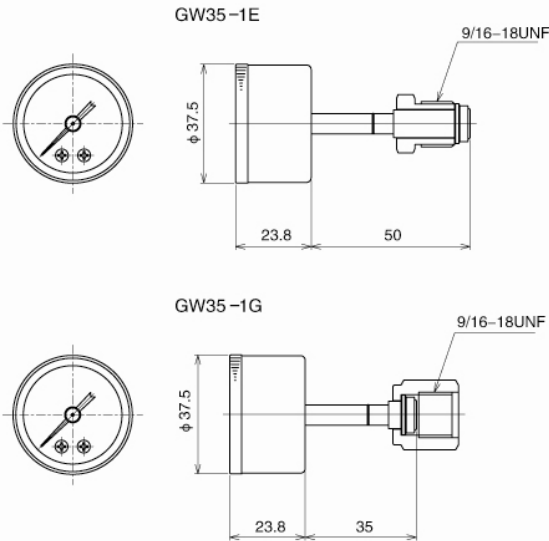
EP级: 直径0.2 μm以上的微粒少于10个

BA级: 等级IV (ANSI B40、1M-1979)

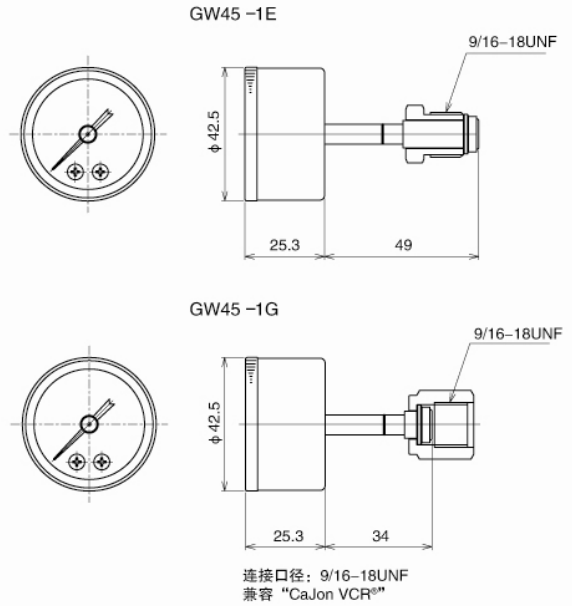
## 级别构成

等级	EP级	BA级
接液部材质	SUS316L (接气部表面研磨)	SUS316L
清洁度	直径0.2 μm以上的 微粒少于10个	等级IV (ASME B40, 7-1998)
泄漏检查	$1.01 \times 10^{-9} \text{ Pa} \cdot \text{m}^3/\text{s}$ 以下	
洗净	①洗净 ②超声波洗净 ③研磨洗净 ④充氮气包装	
适用场合	①一般场合 ②洁净室 (等级10,000) ③净化台 (等级100)	
调整检查 介质	氮气	
包装	聚乙烯袋密封包装	

外形尺寸



结构图



选型规格

选型时请指定型号、规格、压力范围

型号

GW   — 1    — 0 0 0 × × × × × × × × × ×

① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨ ⑩ ⑪ ⑫ ⑬ ⑭ ⑮

半导体行业专用压力表  
BA、EP级

基本型号		基本选型		可选项		
① 型号	3	5	形式			
	4	5	φ35 面板安装			
① 形状	1		D型 (中心径向)			
	② 连接螺纹	E	兼容1/4 VCR阳螺母			
G		兼容1/4 VCR阴螺母				
Q		兼容1/4 VJR阳螺母、带纯净环				
③ 接液部材质	3	SUS316L: BA 级				
	4	SUS316L: EP 级				
(订货时, 请分别标明压力范围和单位)	④ 压力范围 (MPa)	1	0-0.1-0.3, 0.4, 0.6, 1, 1.5, 2			
		2	0-0.4, 0.6, 1, 1.5, 2, 2.5, 3.5			
⑤ 性能	0	标准 (±3.0%F.S.)				
⑥ 指针	0	标准型				
⑦ 玻璃面板	0	标准				
⑮ 资料	0	无				
	1	其他 (请单独标明需求的文件) 图纸、使用说明书、检查要领书、制造工艺流程图表、检测报告 (每个产品1份) 检查/可追溯证明				